

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2025-001

深圳市星源材质科技股份有限公司
关于与株式会社RS Technologies签订
《战略合作框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、《战略合作框架协议》的生效条件

本协议于2025年1月8日签订，双方代表签字盖章之日起生效。

2、本次签订的《战略合作框架协议》属于框架性约定，具体的实施内容和进度存在不确定性，根据后续进展情况，公司将按照《公司章程》及相关规章制度的规定履行相应审议程序及信息披露义务。

3、本次签订的《战略合作框架协议》不涉及具体金额，对公司当期经营业绩及未来业绩增长的影响尚不确定。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、《战略合作框架协议》签署概况

随着半导体材料需求的大幅增长和新型半导体材料研发的加速，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为新能源材料行业的全球领军企业，为进一步发挥公司在材料领域研发、生产和销售的优势，与株式会社RS Technologies达成《战略合作框架协议》，建立长期战略合作关系，共同致力于半导体材料领域协同公关、科技成果转化、科技服务生态等方面的合作交流，推动双方互利共赢。

本次签订《战略合作框架协议》事项无需提交董事会或股东大会审议，不涉及关联交易事项，不构成重大资产重组。

二、合作方介绍

公司名称：株式会社RS Technologies（东证PRM股票代码：3445）

董事长：方永羲

经营范围：半导体硅片制造加工业务；半导体硅片再生加工业务；半导体设备用石英·硅耗材制造加工业务；半导体器件及基板相关加工制造业务；集成电路代工业务；电子部品·半导体设备贸易业务；光伏组件加工业务。

注册地址：東京都品川区大井1-47-1 NT大楼 12F

类似交易情况：最近三年公司与株式会社RS Technologies未发生类似交易。

关联关系：株式会社RS Technologies与公司不存在关联关系。

履约能力：株式会社RS Technologies不属于失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。

三、《战略合作框架协议》的主要内容

甲方：株式会社 RS Technologies

乙方：深圳市星源材质科技股份有限公司

（一）合作内容

1、科技成果转化：甲方愿意优先将其半导体材料科技成果与乙方开展合作交流，双方共同探讨对半导体材料科技成果进行商业化合作，建立符合市场化标准的科技成果转移转化管理运作机制；共同致力于协同半导体材料攻关，建立国际合作交流；

2、产业化投资及商业化赋能：乙方愿意将其优势资源及推动相关第三方与甲方联合共同推进半导体材料科技成果产业化的合作，用商业模式赋能半导体材料科技成果转化及产业化；在两国政策法规允许的范围内，协助中日两地市场的共同研发、销售及半导体材料企业的资源整合等相关工作的实施；

3、信息共享：双方建立沟通机制，定期组织双方交流座谈，保持信息的及时性和准确性；定期组织联合召开专项成果展示会、政策发布会、技术需求发布会等活动，搭建起桥梁纽带作用；

4、其他双方商定的合作领域。

（二）权利和义务

1、甲方权利和义务：

（1）根据本协议内容，甲方优先与乙方探讨半导体材料科技成果转化的商业合作模式并组织项目实施；

（2）甲方应保证其科技成果的真实性和有效性，并在合作过程中提供必要

的技术支持、人才保障等条件。

2、乙方权利和义务：

(1) 乙方有权了解甲方的科技成果，并提出合作建议和方案；

(2) 乙方应利用其商业资源和运营能力，协助甲方推进科技成果的商业化进程。

(三) 其他

1、本协议经双方法定代表人或授权代理人签字之日起生效，有效期五年；

2、双方因履行本协议发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，双方同意可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、《战略合作框架协议》对公司的影响

《战略合作框架协议》的签订，将进一步凸显公司在材料领域的领军地位，进一步发挥公司在材料领域研发、生产和销售的优势，为半导体材料推广带来积极作用；有助于提高公司科技创新能力及竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。同时，也将进一步促进双方发挥各自优势，为双方合作创造更大的商业价值。

五、风险提示

(一) 本次签订的《战略合作框架协议》属于框架性约定，具体的实施内容和进度存在不确定性，根据后续进展情况，公司将按照《公司章程》及相关规章制度的规定履行相应审议程序及信息披露义务。

(二) 本次签订的《战略合作框架协议》不涉及具体金额，对公司当期经营业绩及未来业绩增长的影响尚不确定。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

《战略合作框架协议》

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2025年1月9日